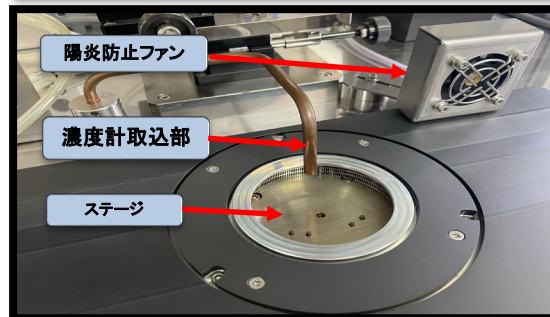
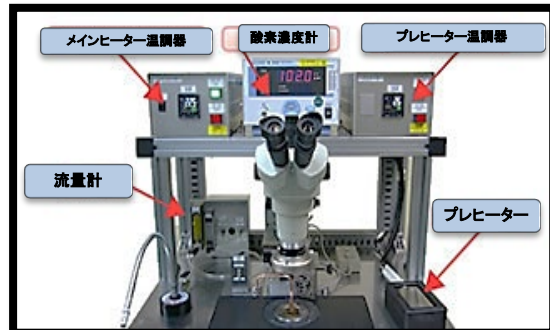


ひとわざ(一技)名: カバー無しで酸素濃度100ppm

1. 概要

- ・基板やパッケージに共晶材(AuSn等)を置きその後チップを実装するマニュアル共晶ダイボンダーです。
 - ・特許取得の機構により、カバー無しでステージ上の酸素濃度100ppm以下を実現しました。
 - ・作業性に優れ、効率化と安定した共晶ダイボンディングが可能になりました。
- ステージ(製品吸着部)の仕様については、設計製作いたしますので、様々な製品に対応可能です。

写真・図(要点説明)



2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ゴトウセイコウ	フリガナ	ゴトウ ツヨシ
会社名	株式会社後島精工	代表者名	後島 剛
		フリガナ	ゴトウ ナオコ
事業内容	金属・非鉄金属加工・装置製造	窓口担当	後島 奈保子
主要製品	電子部品製造用治工具/省力化装置		
フリガナ	ナガノケン スザカシ オオアザ オガワラ		
住所	〒382-0071 長野県須坂市大字小河原2171-5		
電話/FAX	026-245-7217	E-mail	info@gotoseiko.jp
資本金(百万円)	20	設立年月	1972年7月
		売上(百万円)	—
		従業員数	19

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他
 保有特許
 ・電子部品收容用トレイ
 特許第4511990号 - 2010年5月14日
 ・メッキ加工用治具の製造方法
 特許第6164920号 - 2017年6月30日
 ・ボンディング装置の不活性ガスフローシステム
 特許第6419256号 - 2018年10月19日 他